

苏州锴威特半导体股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，全面执行国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的指导要求，积极响应上海证券交易所《关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”）始终秉持“以投资者为本”的发展理念，切实履行上市公司主体责任，制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，并经董事会审议通过。依据行动方案部署，公司有序推进各项重点工作，现将 2026 年上半年度主要成果汇报如下。

一、聚焦主营提质，增强核心竞争力

2026 年上半年，公司继续深耕功率半导体领域，坚定实施“功率器件+功率 IC”双轮驱动战略，重点围绕 BLDC 电机驱动、工业及车用电源、新能源与智能电网、高可靠电源及电机驱动四大核心应用场景，系统打造一体化芯片解决方案。

（一）深化技术研发，完善产品矩阵

报告期内，公司持续加大研发投入，核心产品研发取得重要进展，技术平台建设不断夯实。2026 年上半年，公司研发投入 4,104.79 万元，同比增长 16.43%，占营业收入比例为 25.50%，持续保持高强度研发投入态势。

电源管理 IC 方面：隔离拓扑产品已实现反激、正激、半桥、推挽、全桥、移相全桥系列化，移相全桥控制 IC 获 AEC-Q100 认证并完成终端验证；工业用小型化隔离电源芯片已量产，集成 1700V SiC 器件的高压辅助电源管理芯片进入测试验证阶段，预计下半年发布。非隔离拓扑方面，推出 100V 以上同步 Buck/Boost 控制器，1-8A 同步 Buck 转换器及 SiP 电源模块研发有序推进，已发布 2 颗模块，下半年将再推新品。系统级产品中，理想二极管控制 IC 耐压达 $\pm 150V$ ，为国内外同类最高等级，浪涌抑制控制 IC 完成客户端验证并逐步量产，100V 智能高边开关控制器具备完善保护及预充电功能；同时推进 100V/150V 理想二极管模块研发。

电机驱动 IC 方面：公司持续丰富产品系列，推出面向电动工具领域的 65V 三相半桥驱动 IC、面向无人机、工业伺服及慢速车市场的 250V 三相半桥驱动 IC，以及专用于 SiC MOSFET 的半桥驱动 IC。依托公司在功率器件与驱动 IC 领域的综合优势，公司推出电机驱动用 IPM 模块系列，包括 500V~600V 集成 2A-6A FRMOS 的 IPM 模块、650V 集成 10A SiC MOS 的 IPM 模块、100V 集成 10A SGT MOS 的 IPM 模块。公司电机驱动 IPM 产品线成功进入电机驱动市场。

硅基功率 MOSFET 方面：公司进一步开发完善了沟槽 MOSFET 及 SGT MOSFET 的工艺平台优化和产品布局，开发了 40V~120V SGT 工艺平台，基于 12 寸晶圆产线已开发了系列中低压 SGT MOSFET，服务于无人机、机器人、服务器、BMS 等市场。针对电子负载等对高安全工作区有特殊要求的市场，公司启动 1500V 超高压线性 MOSFET 的研发工作。

SiC 器件方面：公司加大 SiC MOSFET 加工的产能布局及工艺平台的开发，与国内晶圆代工厂合作开发了 750V~3300V SiC MOSFET 的生产工艺平台，并进行了优化与升级，公司已推出 750V、900V 集成 ESD 保护的系列 SiC MOSFET，可以通过 2kV 的 ESD 测试，解决了 SiC MOSFET ESD 能力差的问题。平面 SiC MOSFET 已推进到第 4 代工艺平台，元胞 pitch 缩小至 2.5um，比导通电阻低至 $2.3\text{m}\Omega\cdot\text{cm}^2$ 。同时针对固态断路器的应用，公司启动 SiC JFET 器件的研发工作，当前处于试制阶段，该器件具有低导通、抗短路能力强的优势。

随着第三代半导体 SiC 和 GaN 器件的成熟，使固态继电器由小电流向大电流产品渗透成为可能。公司已研发成功适配 SiC MOSFET 的固态继电器专用光电转换驱动 IC，已成功应用于储能、新能源汽车等应用中。同时公司布局新一代的固态继电器驱动 IC 产品，具备更强驱动能力，用于驱动大电流 SiC MOSFET，提高固态继电器的电流能力，满足大电流应用场合。

知识产权方面，报告期内公司新获授权发明专利 9 项，集成电路布图设计专有权 6 项；截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计共已获授权专利 153 项(其中发明专利 112 项、实用新型专利 41 项)，集成电路布图设计专有权 135 项。形成了较为完善的知识产权保护体系。

（二）精准拓宽市场，优化客户结构

报告期内，公司坚持"功率器件+功率 IC"双轮驱动战略，聚焦四大核心应用

场景，从单一产品供应升级为整套芯片解决方案提供商，以提升客户粘性与市场竞争力。公司前期在高可靠领域积累的技术优势，正积极向工业控制和新能源领域转化。

公司已与超过 600 家客户建立合作关系，客户群覆盖国内高可靠领域电源龙头企业及国家重点科研院所。报告期内，公司进一步拓展了客户覆盖范围，公司通过场景化解决方案以及丰富的产品矩阵和服务能力，不断扩大市场份额，深挖工业储能、光伏逆变、新能源汽车及充电桩、工业电源等细分应用领域的产品需求。

（三）优化运营管理，强化质量管控

报告期内，公司持续优化运营体系，强化供应链管理，提升交付保障能力与经营效率。公司采用 Fabless 经营模式，通过与主要晶圆代工厂和封测厂商建立长期稳定的合作关系，并进行多元供应商储备，成功开发多家关键 FAB 及封测供应商，保障供应链的稳定性与产能安全。

公司秉承全链条质量管理理念，将质量要求贯穿设计、供应链、生产、交付各环节，系统开展质量改进专项行动，攻克产品可靠性技术难题，推动高难度产品良率稳步提升。公司正积极推进 CNAS 认可实验室建设，增强检验检测能力，拓展可靠性验证与认证资源，为车规级及高可靠产品的研发与交付提供有力支撑。报告期内，公司持续加强应收账款管理与存货周转优化，强化销售与运营计划协同，提升需求预测、生产计划、采购及库存管理的联动效率，为经营质量改善奠定坚实基础。

二、持续优化公司治理，提升规范运作水平

报告期内，公司以合规经营为底线，持续完善法人治理结构，深化合规管理体系建设，推动治理效能稳步提升。

（一）完善法人治理结构，保障治理机制高效运行

2026 年上半年，公司紧密跟踪监管政策变化，结合自身发展实际，系统开展内控制度的梳理与优化工作。严格对照《上市公司治理准则》等最新法律法规要求，修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步规范薪酬考核机制，夯实科学治理的制度基础。报告期内，公司共召开董事会 4 次、董事会各专门委员会会议 7 次，确保董事会、专门委员会、独立董事及管理层有效履职，切实维

护公司及中小股东合法权益。

（二）深化合规体系建设，加强内控风险管控

公司坚持将合规管控全面嵌入业务流程，聚焦资金运作、投资决策、信息披露等高风险领域，强化全过程动态管理。持续推进内控流程优化和信息系统化建设，定期或不定期开展业务流程合规排查，及时发现并纠正不规范操作，筑牢风险防控屏障。后续，公司将持续对标监管要求，不断完善治理体制机制，多维度提升内控体系的有效性，进一步增强经营管理水平和风险防范能力，为公司可持续发展提供坚实保障。

（三）强化“关键少数”履职，深化合规责任意识

公司持续向董事、高级管理人员传递最新证券法律法规、监管政策及行业动态，积极组织参加上交所、地方证监局等机构举办的专题培训，不断提升“关键少数”的风险意识、自律意识和履职能力，强化其对公司战略规划和经营管理的统筹引领作用。报告期内，公司董事、高级管理人员累计参加相关培训 6 次，合规履职水平持续提升。

三、深化投资者关系管理，优化互动机制

报告期内，公司始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，以提升信息披露质量为核心，丰富投资者互动渠道，深化与投资者的沟通交流。

（一）提升信息披露质量，履行信息披露义务

公司严格按照法律法规、监管要求及公司制度，及时、准确披露公司经营业绩、重大经营事项、研发进展、战略规划等重要信息，确保信息披露内容的真实性、完整性和公平性，保障投资者的知情权。报告期内，公司按时披露了 2025 年年度报告及 2026 年第一季度报告，以及重大资产重组、募投项目变更等临时公告，信息披露质量持续提升。

（二）丰富投资者互动渠道，深化沟通交流

公司持续畅通上证 e 互动平台、投资者电话、邮箱等常规沟通渠道，安排专人及时响应投资者咨询与问题。2026 年上半年，公司举办了 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的并购进展、业务布局、研发规划等问题进行详细答复，实现了与投资者的深度交流。公司管理层积极通过多渠道主动传递公司战略逻辑与长期价值，持续增强资本市场对公司的信任与认同。

四、重大资产重组有序推进

报告期内，公司积极推进发行股份及支付现金购买晶艺半导体有限公司100%股权并募集配套资金事项。截至本报告期末，本次交易仍在按计划积极推进中，尚未完成。本次交易旨在实现双方的深度业务协同，有望在工控、新能源及消费电子等领域实现客户资源共享与市场拓展，完善产品布局，提升公司整体竞争力。

五、其他相关说明

2026年下半年，公司将继续以本行动方案为指引，持续推进"提质增效重回报"各项工作。公司将继续秉持"功率器件+功率 IC"双轮驱动战略，以技术创新为引擎，加速高附加值产品的商业化进程与市场渗透，持续优化客户结构与供应链布局，致力于实现经营业绩的稳健恢复。

本“提质增效重回报”行动方案评估报告系基于公司目前经营情况和外部环境所作出，未来可能会受到宏观政策、行业竞争、国内外市场环境变化等因素影响，存在一定的不确定性，本方案所涉及的公司规划、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司

董事会

2026年8月27日